特集2

デバイス，パッケージ，ボードの全体最適設計

個別最適化の限界を新技術で乗り越える

本特集では，半導体チップ（LSI），パッケージ，プリント基板の協調設計（コデザイン）について議論します．高速なディジタル信号を取り扱ったり，SiP（system in package）技術などを利用して実装密度を向上させたい場合，「半導体チップだけ」，「パッケージだけ」，「プリント基板だけ」というように個別に設計・検証を考えると不ぐあいが生じる場合があります．チップからパッケージ，基板へと伝搬する信号を包括的に解析したり，実装方式そのものを見直す必要があります．ここでは，こうした問題の背景と対策法，新しい実装方式の提案などを紹介します．



